

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2016.08.13
B/0	升B版	2024.8.14

- 技术参数:
- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
 - 2、额定电流: 3A, AC, DC;
 - 3、额定电压: 250V, AC, DC;
 - 4、温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$;
 - 5、接触电阻: $\leq 0.02 \Omega$;
 - 6、绝缘电阻: $\geq 1000 \text{M}\Omega$;
 - 7、耐压: 1000V, AC/minute.
 - 8、产品料号:

A25001 - n AWB - 03 T1

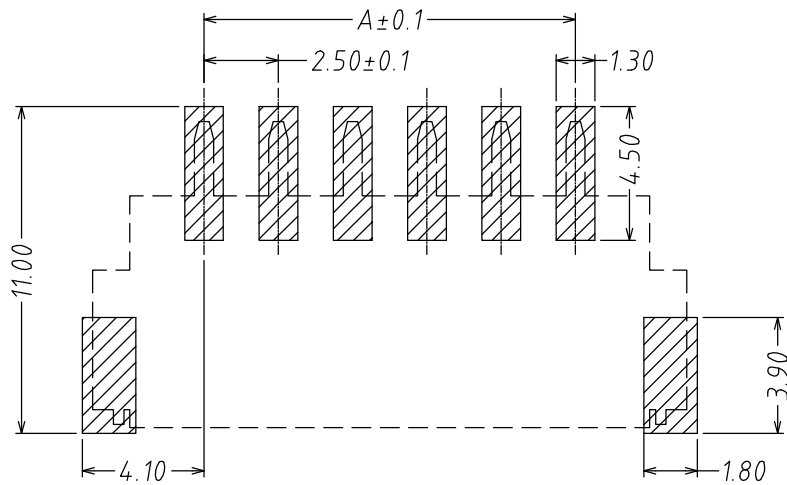
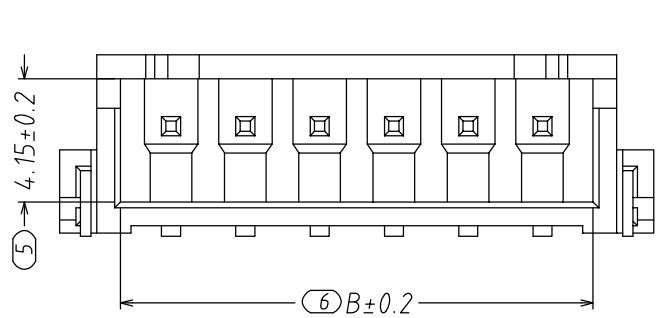
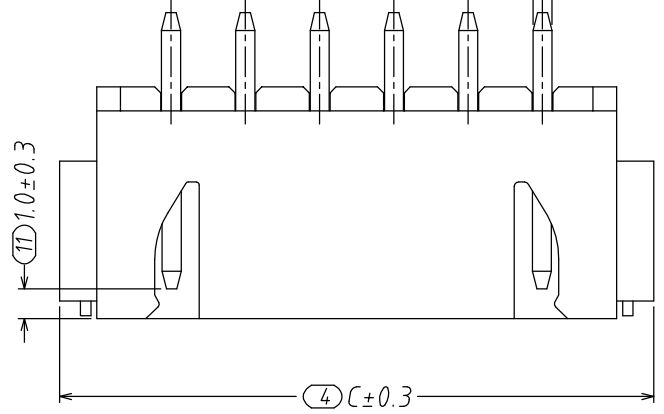
孔位 ———— 电镀
T1: 镀亮锡

产品类型 ———— 胶芯材质
AWB: 卧贴针座 03: LCP 本色

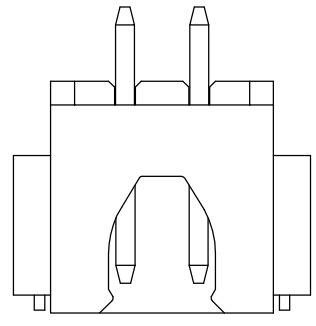
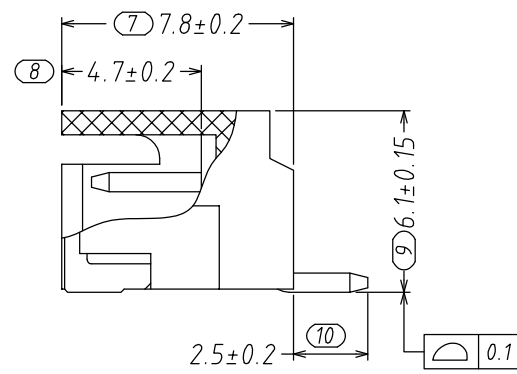
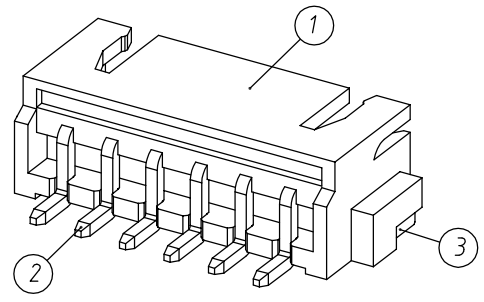
① $A \pm 0.25$

② 2.5 ± 0.15

③ $\square 0.64 \pm 0.03$



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



2PIN外观

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	2.50	5.90	10.00
03	5.00	8.40	12.50
04	7.50	10.90	15.00
05	10.00	13.40	17.50
06	12.50	15.90	20.00
07	15.00	18.40	22.50
08	17.50	20.90	25.00
09	20.00	23.40	27.50
10	22.50	25.90	30.00
11	25.00	28.40	32.50
12	27.50	30.90	35.00
13	30.00	33.40	37.50
14	32.50	35.90	40.00
15	35.00	38.40	42.50
16	37.50	40.90	45.00

序号	名称	材料	数量	附注
3	薄片 fitting	黄铜	2	电镀(镍): 整个表面镀层 $30\mu\text{MIN}$,再镀锡 $80\mu\text{MIN}$.
2	端子 Contact	黄铜	n*1	电镀(镍): 整个表面镀层 $30\mu\text{MIN}$,再镀锡 $80\mu\text{MIN}$.
1	基板 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色

GENERAL TOLERANCES		DRAWN BY 罗荣程/2024.8.17		浙江深海电子有限公司	
0.X	± 0.25	X. $^{\circ}$	$\pm 3^{\circ}$		
0.XX	± 0.12	CHK. BY 朱江浩/2024.8.17		SHEET	PROD. NAME SH-XH2.54-NAWT
0.XXX	± 0.05	X.X. $^{\circ}$	$\pm 0.5^{\circ}$	APRV. BY 姚 婷/2024.8.17	PART NO. A25001-nAWB-03T1
UNIT	SIZE	SCALE	DRAWING NO. H25002-00	1 OF 1	
MM	A4	1:1		TITLE 2.5mm pitch 90° WAFER-SMT TYPE	

借用登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期